

## MEF 2022 Exhibitors Presentation Timetable

## 出展者プレゼンテーションスケジュール

Presentation Date	#	所属機関名	Affiliation	プレゼンテーションタイトル	Presentation Title	プレゼンター	Presenter
<b>April 20, 2022</b>		<b>Exhibitors Presentation Session</b>	<b>Chaired by: Sadaharu Takimoto/Hamamatsu Photonics 瀧本 貞治氏 (浜松ホトニクス)</b>				
<b>12:40-13:40</b>	1	株式会社ティ・デイ・シー	TDC Corporation	超精密研磨加工～プラズマ援用研磨～	Ultra Precise Polishing Service ~Plasma-Assisted Polishing~	前田 知里	Chisato Maeda
	2	ローム株式会社	ROHM Co., Ltd.	ROHM Group Technology Synergies Enable Innovative Products	ROHM Group Technology Synergies Enable Innovative Products	内貴 崇	Takashi Naiki
	3	株式会社アドバンステクノロジー	ADVANCED TECHNOLOGIES CO.,LTD.	MEMS用統合解析ツールIntelliSuiteの最新事例と動向の紹介	Introduction of the latest case studies/trends of IntelliSuite, Total MEMS Solutions	平出 隆一	Hirade Ryuichi
	4	ズース・マイクロテック株式会社 / 兼松PWS株式会社	SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD.	SUSS MICROTEC "GREEN" WAFER CLEANER AND INKJET PRINTER FOR MEMS APPLICATIONS	SUSS MICROTEC "GREEN" WAFER CLEANER AND INKJET PRINTER FOR MEMS APPLICATIONS	石田 博之	Hiroyuki Ishida
	5	Adeia (Xperi)	Adeia (Xperi)			Abul Nuruzzaman	Abul Nuruzzaman
	6	BMF Japan	BMF Japan	Application of P $\mu$ SL 3D Printing in Research and Fabrication in Laboratory	Application of P $\mu$ SL 3D Printing in Research and Fabrication in Laboratory	Junhui Lu (June)	Junhui Lu (June)
<b>April 20, 2022</b>		<b>Exhibitors Presentation Session</b>	<b>Chaired by: Yasuo Hayakawa/AlpsAlpine 早川 康男氏 (アルプスアルパイン)</b>				
<b>16:05-17:05</b>	1	タッチエンス株式会社	Touchence Inc.	MEMS技術による触覚センサ	Tactile sensors based on MEMS technology	丸山 尚哉	Naoya Maruyama
	2	協同インターナショナル	Kyodo International, Inc.				
	3	SPPテクノロジーズ株式会社	SPP Technologies Co., Ltd.	SPPテクノロジーズのMEMS製造装置	MEMS Manufacturing Equipment of SPP Technologies	藤村 剛	Tsuyoshi Fujimura
	4	丸紅情報システムズ株式会社	MARUBENI INFORMATION SYSTEMS Co., Ltd.	表面活性化接合装置	Surface activated bonding system	武田 弘高	Hiroataka Takeda
	5	ウシオ電機株式会社	Ushio Inc.	一括プロジェクション露光装置のご紹介 (UX-4シリーズ)	Full projection field aligner Introduction for UX-4 series	金田 優人	Masato Kaneda
<b>April 21, 2022</b>		<b>Exhibitors Presentation Session</b>	<b>Chaired by: Hiroyuki Ishida/Suss Microtec 石田 博之氏 (ズース・マイクロテック)</b>				
<b>13:55-14:55</b>	1	坂口電熱株式会社	SAKAGUCHI E.H VOC CORP.	原子レベルアンチエイリアス熱処理ミニマル装置	Atomic-Antialiasing Annealing Minimal Fab Tool	濱田 健吾	Kengo Hamada
	2	エーエスエムエル・ジャパン株式会社	ASML Japan Co., Ltd.	エーエスエムエルの提供するMEMS市場向け製品とサービス	ASML products and services for MEMS market	高井 雄司	Yuji Takai
	3	ポリテックジャパン株式会社	Polytec Japan	SiパッケージングMEMSの3次元ダイナミクスの可視化	Visualization of dynamic response of capped MEMS	フランソワ ブテイ	Francois Bouteille
	4	日清紡マイクロデバイス株式会社	Nisshinbo Micro Devices Inc.	日清紡マイクロデバイスのスマートセンシング・モジュール設計技術	Smart sensing module design technologies of Nisshinbo Micro Devices	大道 貴志	Takashi OMICHI
	5	新光電気工業株式会社	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.	センシングエッジデバイス紹介	Introduction of Sensing Edge Device	堀内 拓哉	Horiuchi Takuya
	6	住友精密工業株式会社	SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO., LTD.	住友精密グループの「MEMSソリューション」	"MEMS Solutions" in Sumitomo Precision Group	宮島 博志	Hiroshi Miyajima